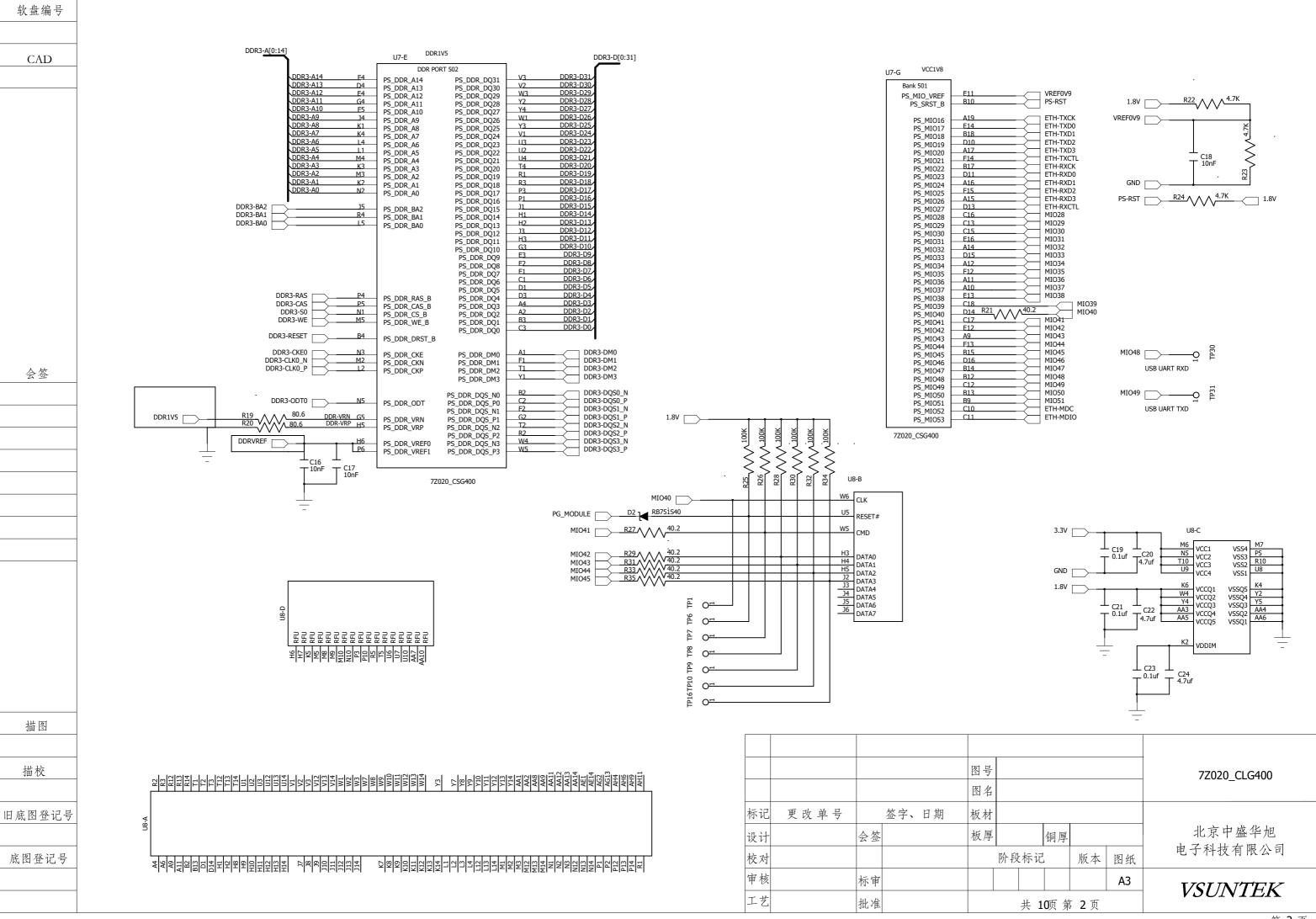


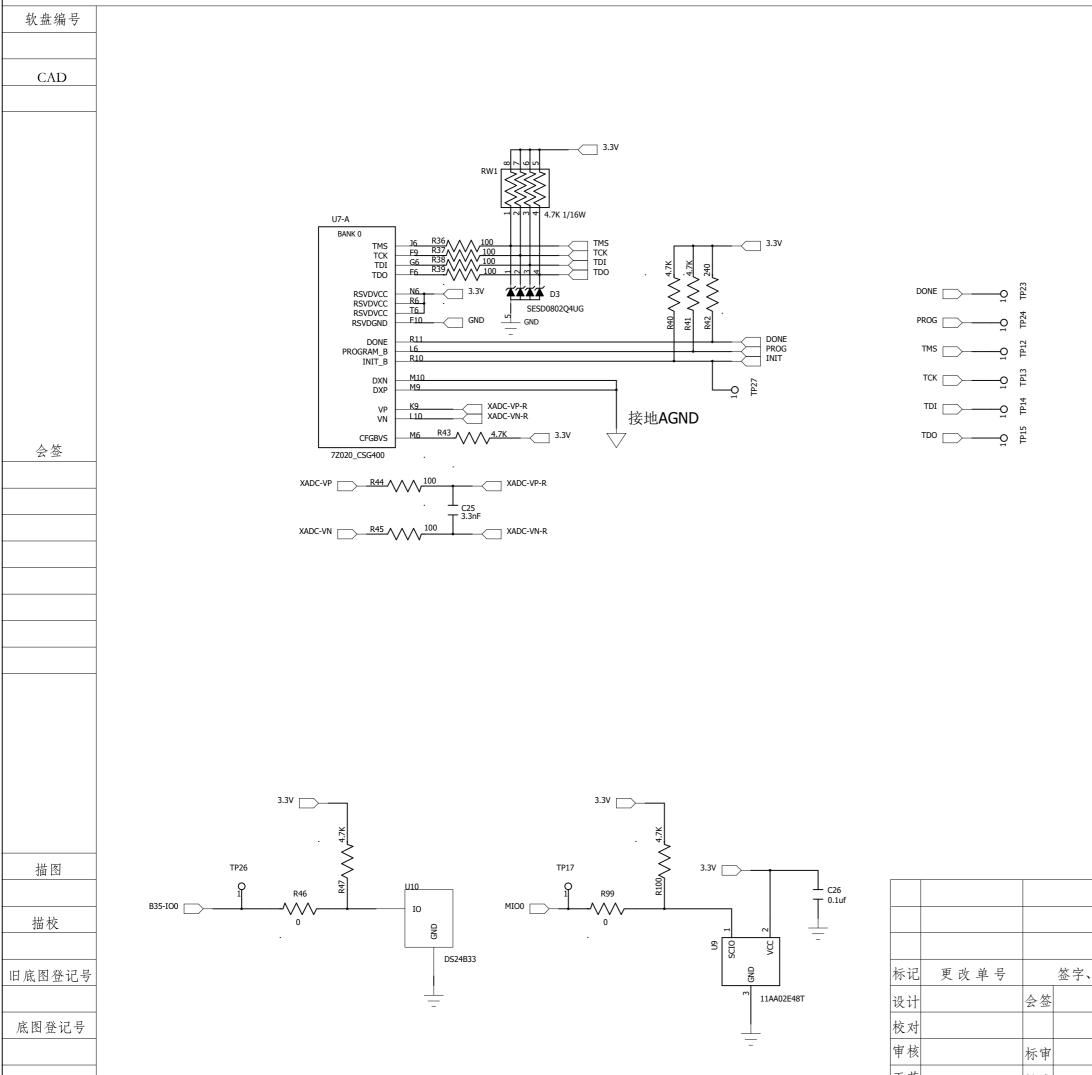
7Z020_CLG400					图号							
					图名							
					板材	期	签字、日		(单号	更改	标记	
北京中			铜厚		板厚			会签			设计	
电子科技	图纸	版本		段标记							校对	
VSUI	A3							标审			审核	
VSUI		5 1页	0 页 第	共 1	·			批准			工艺	

北京中盛华旭 电子科技有限公司

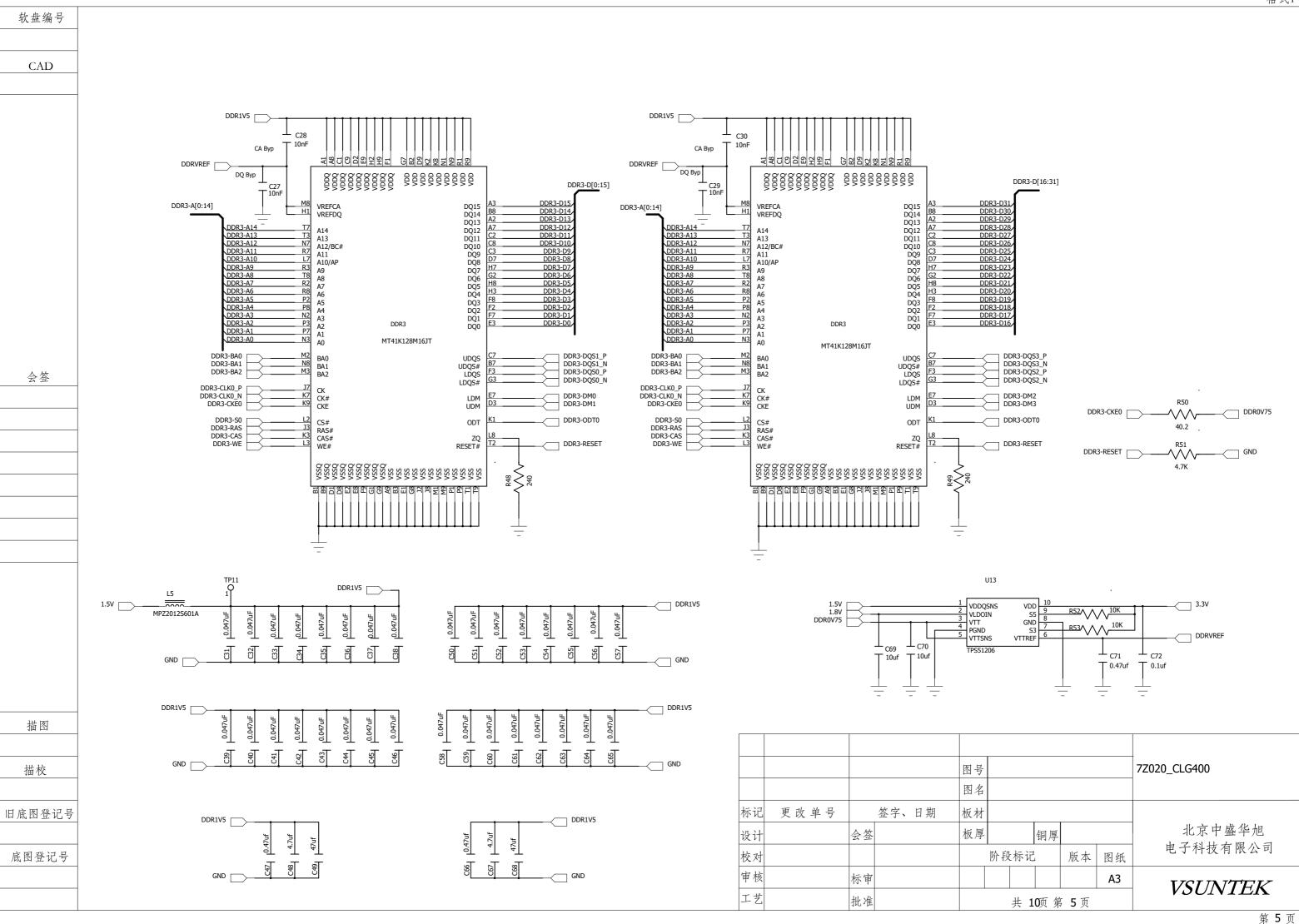
VSUNTEK

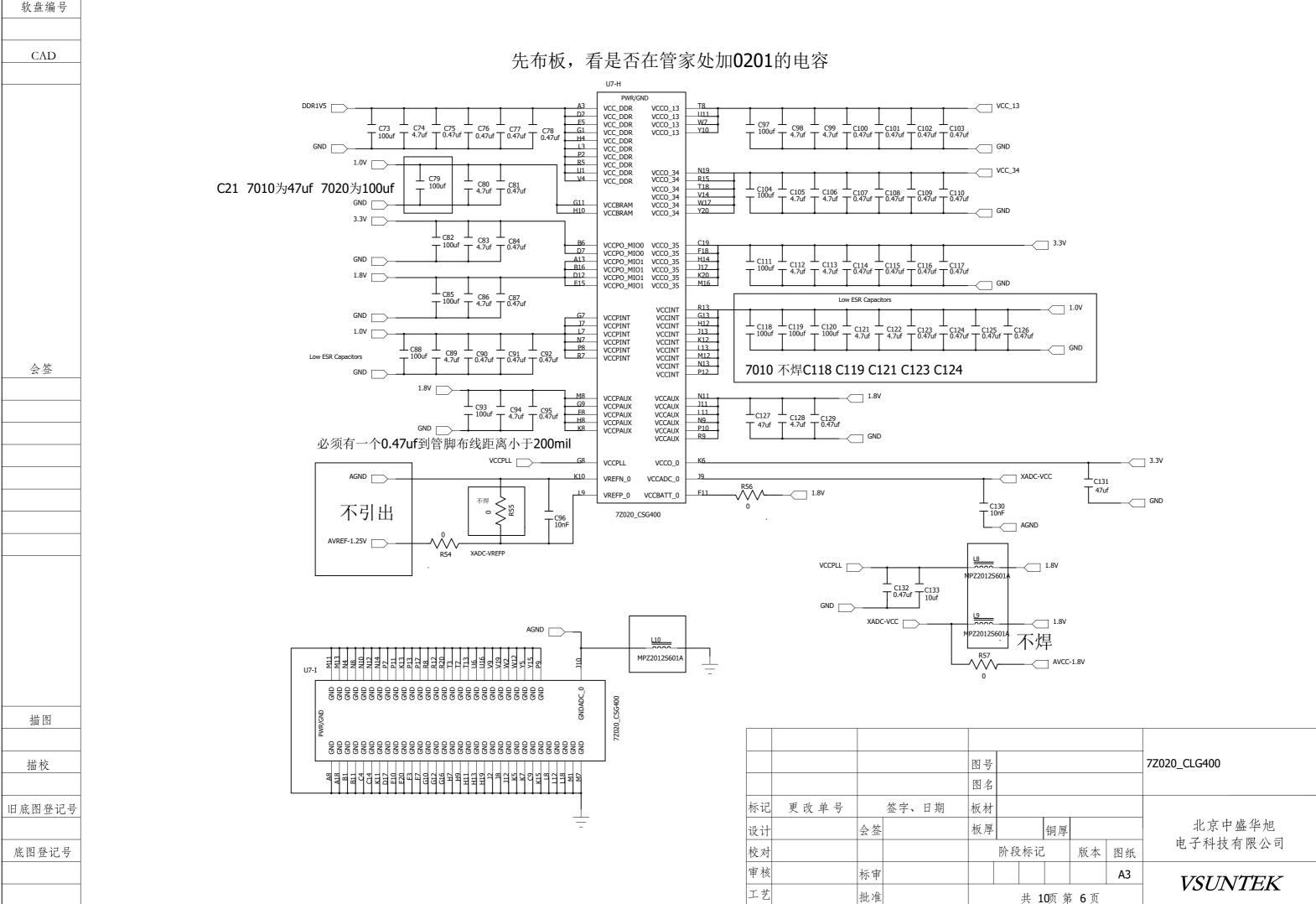


Cold	软盘编号														
Victor V	CAD														
### 1	O/ID														
### 1															
(日) 10		U7-			Г	BANK 34									
# 2						IO_25 T <u>19</u> IO_L1N_T0 T10	B34-I025 B34-L1N		1	TO 25 J15	B35-I0 B35-L	D25 1N			
# 2						IO_L2N_T0 U12_ IO_L2N_T0 T12_	B34-L2N B34-L2P		10.13	IO_L1P_IO_ADOP O_L2N_T0_AD8N IO_L2P_T0_AD8P N_T0_DOS_AD1N D18	B35-L B35-L B35-L	2N 2P 3N			
### (1997) 1997						IO_L3P_T0_DQS_PUDC_B IO_L4N_T0 IO_L4P_T0 V12	B34-L4N B34-L4P		10_L3	IO_L4N_T0 D20 D19	B35-L B35-L	4N 4P			
10 (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1						IO_L5N_T0	B34-L5P B34-L6N]	O_L5N_T0_AD9N	B35-L B35-L	5P 6N			
サンド 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						IO_L7N_T1	B34-L7N B34-L7P B34-L8N		I		B35-L B35-L B35-L	7N 7P BN			
全意						TO 18P T1 W14	B34-L9N B34-L9P		IO_L9 IO_L9	D_L8P_T1_AD10P N_T1_DQS_AD3N IP_T1_DQS_AD3P	B35-L B35-L	9N 9P			
### 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			IO_L11N_T1_SRCC	<u>V7</u> B13-L11N		IO_L10P_11 IO_L11N_T1_SRCC	B34-L10P B34-L11N		IO IO	L10N_T1_AD11N	B35-L B35-L	10P 11N			
10 10 10 10 10 10 10 10			IO_L12N_T1_MRCC - IO L12P T1 MRCC -	U10 B13-L12N T9 B13-L12P Y6 B13-L13N		IO_L12N_T1_MRCC	B34-L12N B34-L12P B34-L13N		I IC	D_L12N_T1_MRCC	B35-L B35-L B35-L	12N 12P 13N			
19 19 19 19 19 19 19 19	会签		IO_L13P_T2_MRCC - IO_L14N_T2_SRCC - IO_L14P_T2_SRCC -	Y8 B13-L14N Y9 B13-L14P		IO_L13P_T2_MRCC	B34-L14N B34-L14P		IO_L14N IO_L14F	T2_AD4N_SRCC 188 P_T2_AD4P_SRCC 188	B35-L B35-L	14N 14P			
### 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			IO_L15P_T2_DQS - IO_L16N_T2 -	V8 B13-L15P B13-L16N		IO_L15N_T2_DQS IO_L15P_T2_DQS IO_L16N_T2 W20_	B34-L15P B34-L16N		IO_L15P	P_T2_DQS_AD12P F19	B35-L B35-L B35-L	15P 16N 16P			
## 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			IO_L17N_T2 - IO_L17P_T2 - IO_L18N_T2 -	U9 B13-L17P B13-L18N		IO_L17N_T2	B34-L17P B34-L18N		IO	D_L17P_T2_AD5P	B35-L B35-L	17P 18N			
##IE ##IE			IO_L19N_T3_VREF IO_L19P_T3	U5 B13-L19N B13-L19P B13-L20N		IO_L19N_T3_VREF R17_ IO_L19P_T3 R16_ IO_L20N_T3 R18_	B34-L19N B34-L19P		10	D_L19N_T3_VREF G15 IO_L19P_T3 H15	B35-L B35-L	19N 19P			
10 10 10 10 10 10 10 10			IO_L20P_T3 - IO_L21N_T3_DQS - IO_L21P_T3_DQS -	Y12 B13-L20P V10 B13-L21N V11 B13-L21P		IO_L20P_T3	B34-L21N B34-L21P		IO 121N	D_L20P_T3_AD6P	B35-L B35-L	21N 21P			
10.1240.7 10.			IO_L22N_T3 - IO_L22P_T3 -	W6 B13-L22N B13-L22P		IO_L22P_T3	B34-L22P B34-L23N		IC	D_L22N_T3_AD7N	B35-L B35-L	22P 23N			
描数						IO_L24N_T3 P16_	B34-L24N		IO_ IO,	L24N_T3_AD15N J16	→ B35-L	24N			
描校 图号 72020_CLG400 版图登记号 图名 图名 标记 更改单号 签字、日期 板材 设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭 电子科技有限公司 审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3页 **VSUNTEK**			7Z020_CSG400		L	7Z020_CSG400			720	020_CSG400					
描校 图号 72020_CLG400 版图登记号 图名 图名 标记 更改单号 签字、日期 板材 设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭 电子科技有限公司 审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3页 **VSUNTEK**															
描校 图号 72020_CLG400 版图登记号 图名 图名 标记 更改单号 签字、日期 板材 设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭 电子科技有限公司 审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3页 **VSUNTEK**															
描校 图号 72020_CLG400 版图登记号 图名 图名 标记 更改单号 签字、日期 板材 设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭 电子科技有限公司 审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3页 **VSUNTEK**															
描校 图号 72020_CLG400 版图登记号 图名 图名 标记 更改单号 签字、日期 板材 设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭 电子科技有限公司 审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3页 **VSUNTEK**															
描校 图号 72020_CLG400 版图登记号 图名 图名 标记 更改单号 签字、日期 板材 设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭 电子科技有限公司 审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3页 **VSUNTEK**	世 囡														
底图登记号 版记 更改单号 签字、日期 板材 设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭电子科技有限公司 校对 阶段标记 版本 图纸 电子科技有限公司 审核 标审 日	加口														
底图登记号 签字、日期 板材 设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭 长对 防段标记 版本 图纸 审核 标审	描校										图号				7Z020_CLG400
设计 会签 板厚 铜厚 北京中盛华旭 校对 阶段标记 版本 图纸 审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3页 **VSUNTEK*															
校对 阶段标记 版本 图纸 审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3 页 电子科技有限公司 VSUNTEK	底图登记号								更改单号			石石			北京中盛华旭
审核 标审 A3 工艺 批准 共 10页第 3 页	 ≲图登记号											<u> </u>	版本	图纸	
 								-		标审					<i>I/CI INTTUV</i>
" • □								工艺		批准		共 10页 第	5 3 页		

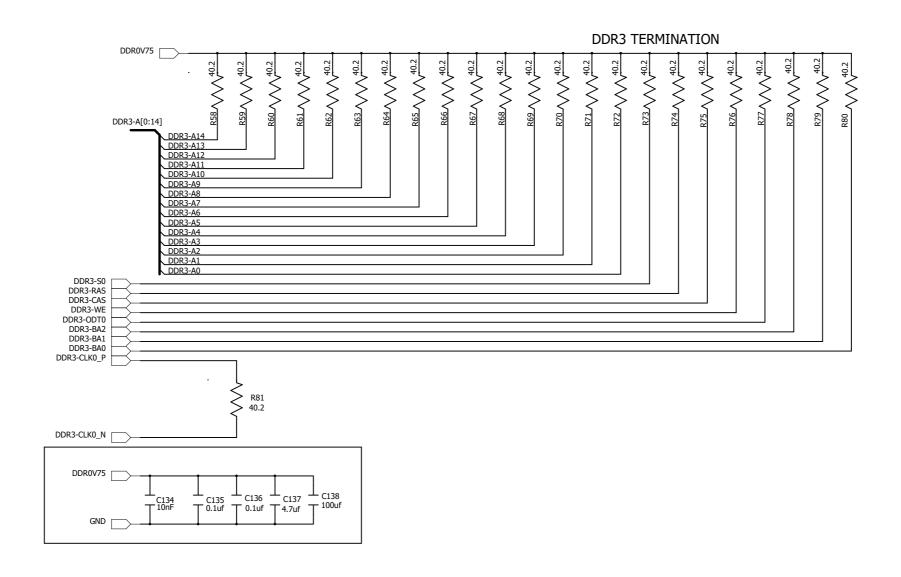


					图号						7Z020_CLG400
					图名						
标记	已 更改单号		签字、	日期	板材						
设记	+	会签			板厚			铜厚			北京中盛华旭
校又	+					阶段	设标记		版本	图纸	电子科技有限公司
审相	亥	标审								A3	VSUNTEK
工艺		批准					共 1	0 页 第	4页		VSUIVILIN





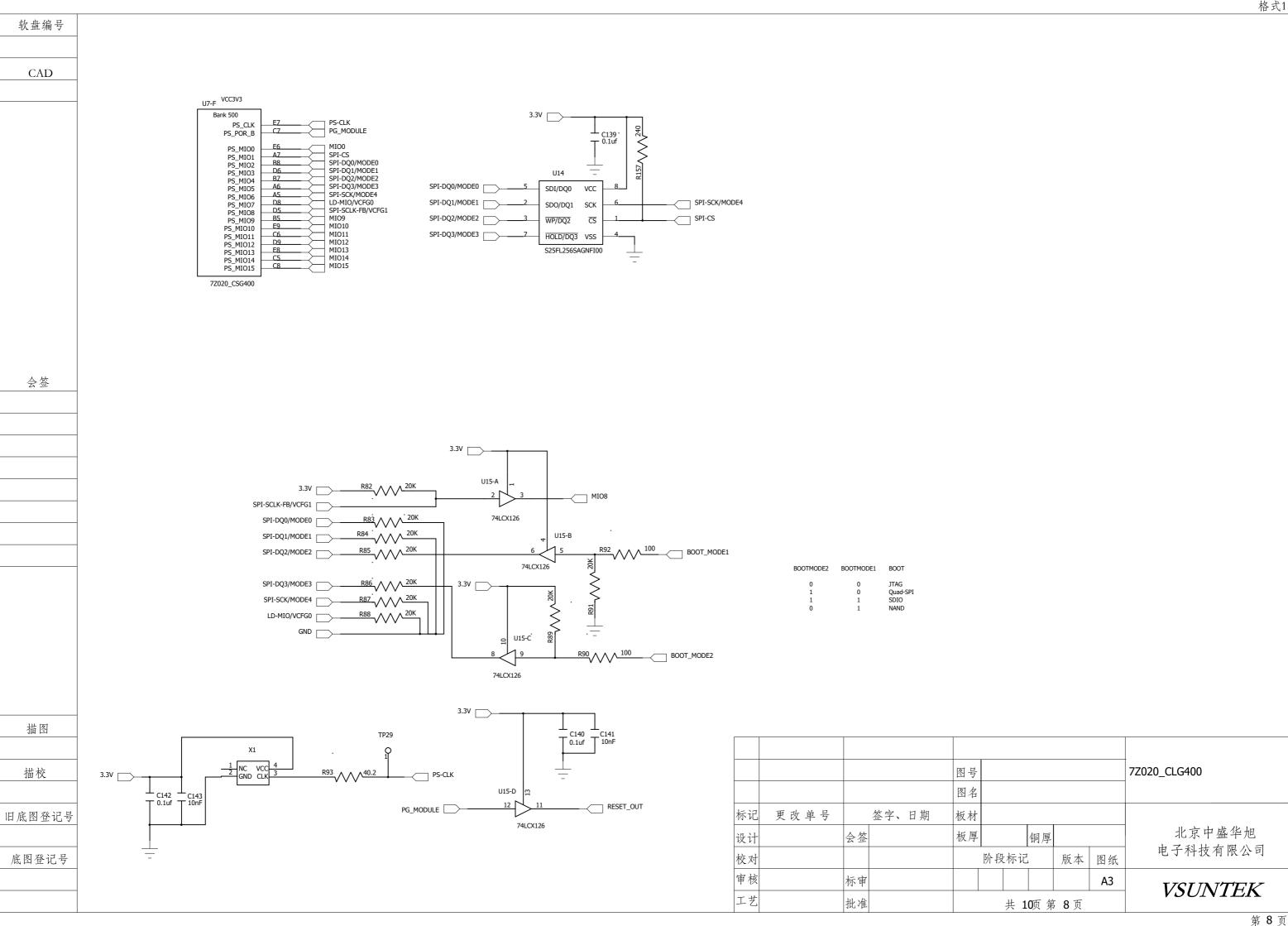




图号 7Z020_CLG400 图名 更改单号 签字、日期 板材 北京中盛华旭 板厚 设计 会签 校对 阶段标记 版本 图纸 审核 标审 А3 **VSUNTEK** 工艺 共 10页 第 7页

NOTE: All Termination Resistors are 1%.

电子科技有限公司



软盘编号

CAD

会签

BKP2125HS221-T BKP2125HS221-T ⊥ C144 $\perp_{\text{C152}} \perp_{\text{C153}} \perp_{\text{C154}} \perp_{\text{C155}}$ $\perp_{\text{C151}} \uparrow_{\text{0.1uf}} \uparrow_{\text{0.1uf}} \uparrow_{\text{4.7uf}}$ 1.0V C146 C147 C148 T 0.1uf T 0.1uf T 4.7uf AVDD18_OUT AVDD18 AVDD18 AVDD18 AVDDC18 33 30 34 DVDD_OUT DVDD DVDD GND ___ ETHAVDD ____ $\perp_{C149} \perp_{C150} \perp_{C151}$ $\perp_{0.1uf} \perp_{0.1uf} \perp_{4.7uf}$ 7 43 VDDO VDDO VDDO AVDD33 16 AVDD33 21 上 _{C156} 丁 ^{0.1uf} 上 _{C157} 丁 ^{0.1uf} ETH-RXCK ETH-RXCTL ETH-TD0_P ETH-TD0_N ETH-RXD0 ETH-RXD1 ETH-TD1_P ETH-TD1_N 38 RXD0 39 RXD1 41 RXD2 42 RYD3 ETH-TD3_N MDIN3 ETH-TXD0 ETH-TXD1 ETH-TXD2 44 45 TXD1 TXD1 TXD2 TXD3 HSDACP 27 HSDACN 26 R97 54.9 ETH-LDL ETH-LDR ETH-MDIO ETH-MDC LED2/INT 6 12 RESET RSET PG_MODULE CONFIG RB751S40 XTAL_IN 29 XTAL_OUT 28 32 REGCAP1 REGCAP2 X2 25MHz 88E1518-AO-NNB2C000

描图

描校

旧底图登记号

底图登记号

 图号
 72

 图名
 图名

 标记 更改单号
 签字、日期 板材

 设计 会签
 板厚

 校对
 阶段标记 版本 图纸

 审核
 A3

 工艺
 批准

 共 10页 第 9页

7Z020_CLG400

北京中盛华旭 电子科技有限公司

VSUNTEK

